



GE벤처스, 삼성전기와 글로벌 마이크로일렉트로닉스 패키징 특허 계약 체결

2017년 2월 16일, 니스카유나 & 수원 – GE 벤처스는 오늘 전자부품 제조 전문기업인 삼성전기(SEMCO)와 다년간의 글로벌 특허 라이선스 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 파트너십을 통해 삼성전기는 전자회로를 내장한 반도체 패키징용 기판의 제조기술을 포함하는 GE의 마이크로일렉트로닉스 패키징 (Microelectronics Packaging) 특허 포트폴리오에 대한 라이선스를 사용할 수 있게 되었다.

GE 글로벌리서치는 지난 10년간 전자부품 연구 분야의 주요 영역 중 하나로 Imbera Electronics Oy (현재 GE Embedded Electronics Oy)사와 함께 해당 특허 포트폴리오를 개발했다. 이번 특허 포트폴리오는 고성능의 통신 및 모빌리티 제품에 특히 중요하게 적용될 전망이다.

GE 벤처스의 마이크로일렉트로닉스 패키징 프로그램을 총괄하는 로렌스 데이비스(Lawrence Davis) 부사장은 “전자부품 분야의 선도기업인 양사가 GE의 IP 포트폴리오의 중요성을 함께 공유하게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며, “최근 모빌리티 제품에서 전력 효율성 제고와 고성능에 대한 요구가 지속적으로 확대되고 있는 가운데, GE는 전력전자 및 가전 분야에서 임베디드 전자기술을 위한 강력한 파트너로 자리매김했다”고 말했다.

GE 벤처스는 특허 라이선싱과 공동개발 파트너십 등을 통해 GE 기술에 대한 접근성을 제공함으로써 파트너사의 혁신 및 성장을 보다 가속화하고 있다. GE의 독보적인 마이크로일렉트로닉스 패키징 기술은 현재 라이선싱을 통해 글로벌 제조 파트너사들이 전 세계적으로 혁신적인 비즈니스 솔루션을 제공하는데 사용되고 있다.

###

삼성전기에 대하여

삼성전기는 다양한 산업 분야 내 수동부품을 공급하는 글로벌 선진기업으로, 디지털 모듈 (DM), 첨단 전자회로기판(ACI), LCR(Linkage of Capacitor, Resistor)의 세 가지 주요 사업부문으로 구성되어 있다. 현재 5개국에 제조시설을 갖추고 있으며, 전세계 15개국 이상에서 직접판매 시스템을 운영하고 있다.

GE 벤처스에 대하여

GE 벤처스는 더 나은 세상을 만들기 위한 모토로 새로운 아이디어를 발굴하고 확대하며, 가속화하는데 중점을 두고 있다. 소프트웨어, 첨단제조, 에너지, 헬스케어 영역에서 자본투자, 새로운 비즈니스 창출, 라이선싱, 기술 이전 등과 같은 활동을 통해 GE 및 파트너사의 성장을 실현하기 위한 혁신적인 플랫폼을 제공해오고 있다. 자세한 정보는 <http://www.geventures.com> 웹사이트 및 트위터(@GE_Ventures), 링크드인 참조